

Title (en)

Probe for an ultrasonic apparatus with a bar composed of piezo-electric elements.

Title (de)

Wandler für ein Ultraschallgerät mit einem Stab von piezoelektrischen Elementen.

Title (fr)

Sonde d'appareil à ultrasons à barrette d'éléments piézoélectriques.

Publication

**EP 0270448 A1 19880608 (FR)**

Application

**EP 87402637 A 19871124**

Priority

FR 8616663 A 19861128

Abstract (en)

[origin: WO8804092A1] The electric connection between the control circuits (13, 14) of a probe and the metallized faces (5, 6) of the piezoelectric elements (2) of said probe is provided by metallizations (6, 8) made on parts, support (1) or blade (4) in contact with said metallized faces. The mechanical and electric connection between said metallizations may be provided by a thin layer of non-conducting glue (19, 20).

Abstract (fr)

La liaison électrique entre les circuits (13,14) de commande d'une sonde et les faces métallisées (5,6) des éléments (2) piéso-électriques de cette sonde est assurée par des métallisations (7,8) réalisées sur des pièces, support (1) ou lame (4) au contact de ces faces métallisées. La liaison mécanique et électrique entre ces métallisations peut être assurée par une mince couche de colle (19,20) non conductrice.

IPC 1-7

**G10K 11/34**

IPC 8 full level

**G01N 29/24** (2006.01); **A61B 8/00** (2006.01); **B06B 1/06** (2006.01); **H04R 17/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B06B 1/0622** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/42** (2015.01 - EP US)

Citation (search report)

- [Y] EP 0005265 A2 19791114 - SIEMENS AG [DE]
- [A] EP 0140363 A2 19850508 - ADVANCED TECH LAB [US]
- [A] US 4276491 A 19810630 - DANIEL KEITH P
- [Y] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 27 (E-156)[1172], 3 février 1983; & JP-A-57 181 299 (YOKOGAWA DENKI SEISAKUSHO K.K.) 08-11-1982

Designated contracting state (EPC)

ES GR

DOCDB simple family (publication)

**EP 0270448 A1 19880608**; CA 1298395 C 19920331; EP 0333738 A1 19890927; FR 2607593 A1 19880603; FR 2607593 B1 19890721; JP H02501611 A 19900531; US 5044370 A 19910903; WO 8804092 A1 19880602

DOCDB simple family (application)

**EP 87402637 A 19871124**; CA 552751 A 19871125; EP 87907783 A 19871124; FR 8616663 A 19861128; FR 8700465 W 19871124; JP 50006987 A 19871124; US 36836489 A 19890524